

易華電子股份有限公司



股票代號：6552

2021/12/16

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



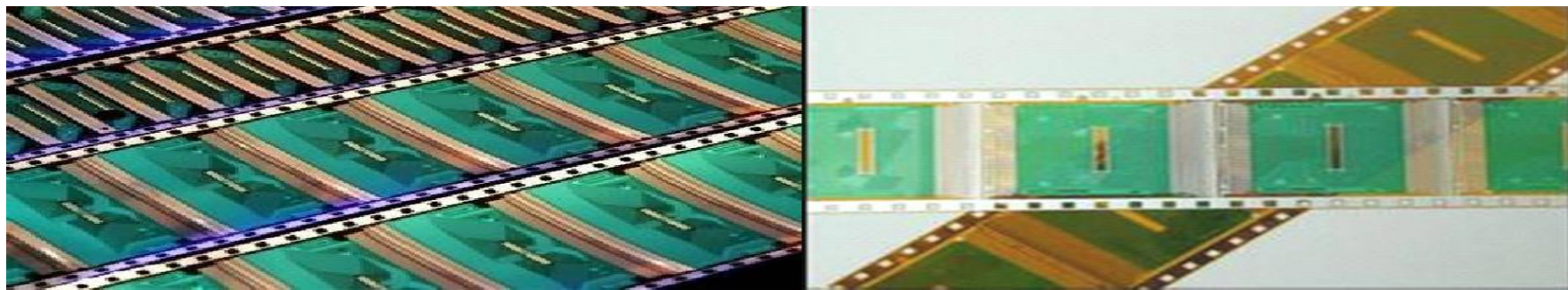
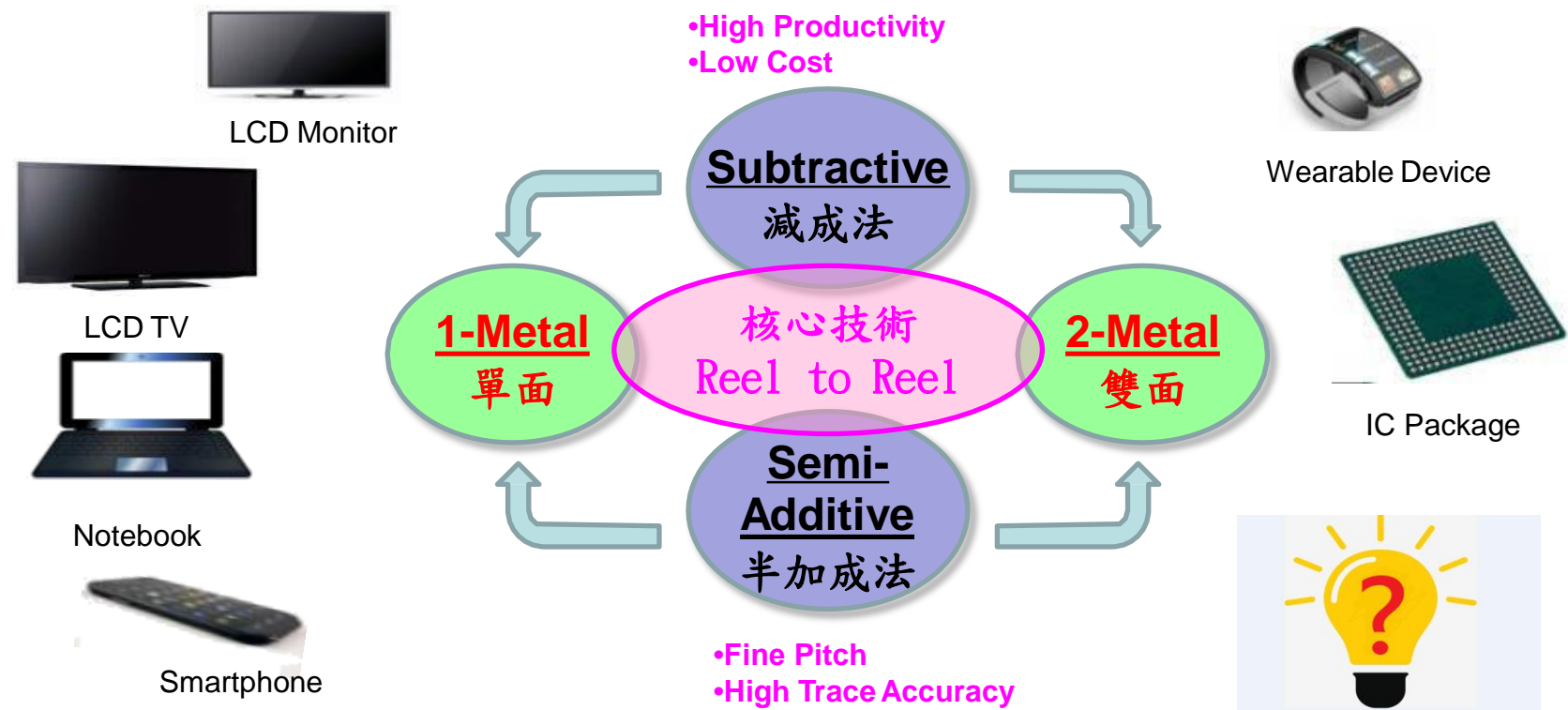
-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

一、公司概况-基本資料

- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董事長：黃嘉能
- 總經理：李宛霞
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42%、南茂10%
- 員工人數：817人(截至2021年11月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地 址：高雄市楠梓區新開發路8號



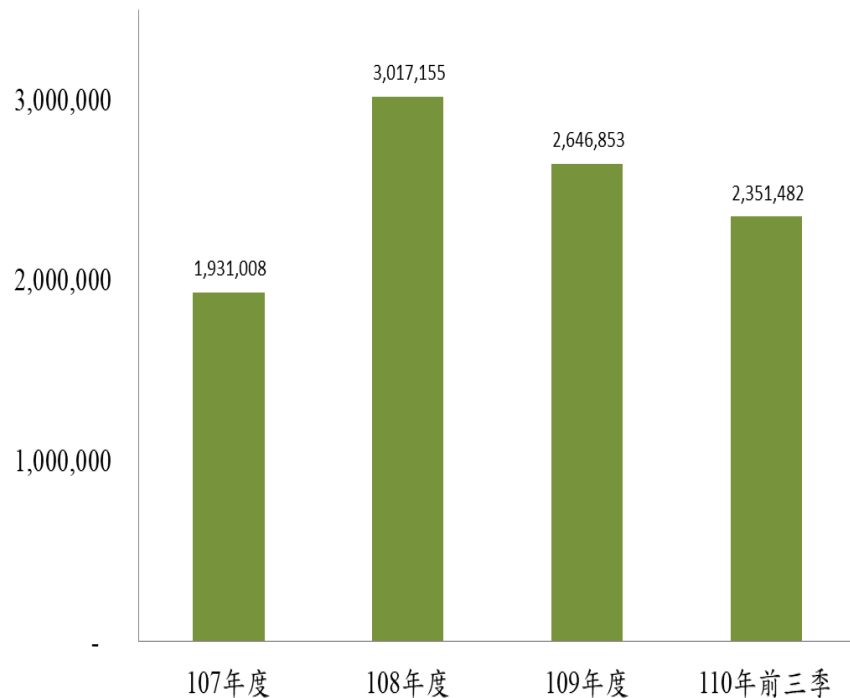
一、公司概況-產品應用



二、營運績效-歷年營收及獲利

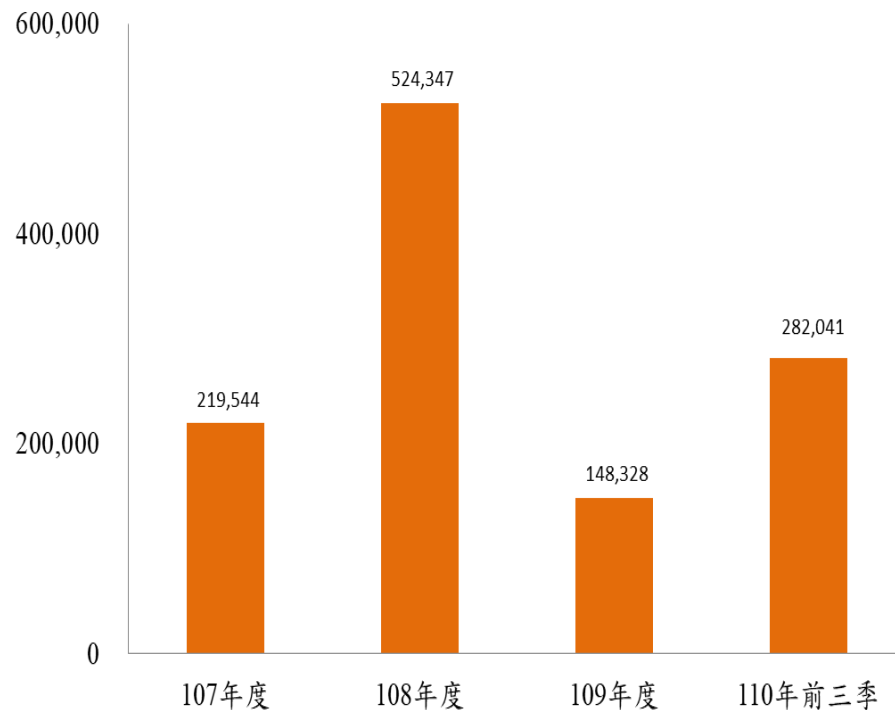
單位:仟元

營業收入



單位:仟元

稅後純益

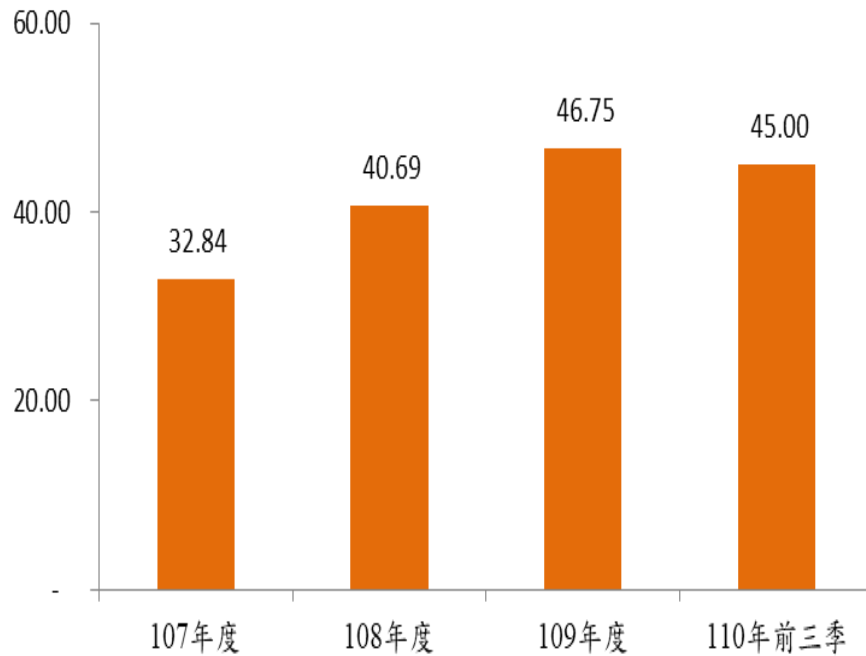


單位：新台幣仟元

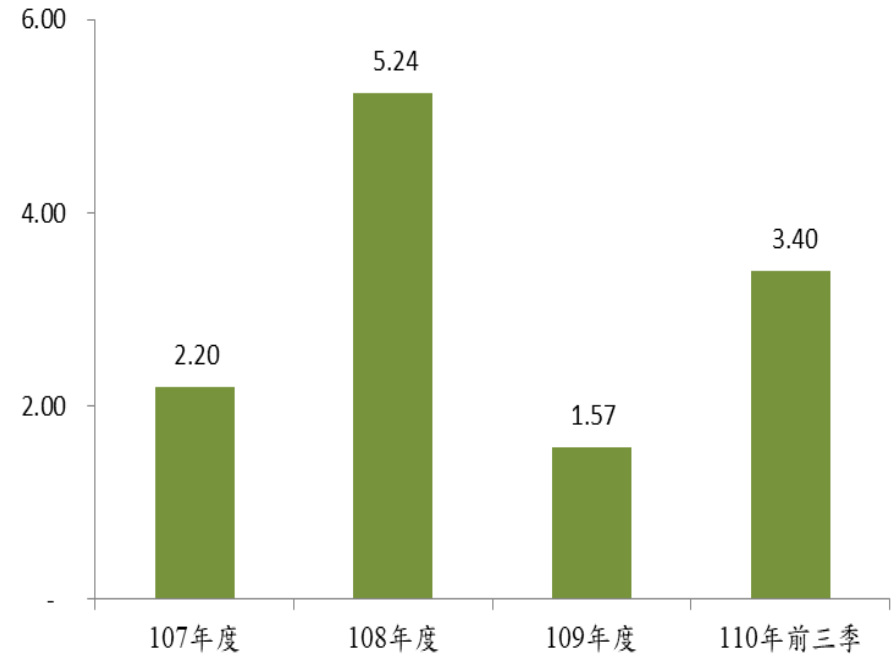
年度	107年度	108年度	109年度	110年前三季
營業收入	1,931,008	3,017,155	2,646,853	2,351,482
稅後純益	219,544	524,347	148,328	282,041

二、營運績效-財務比率分析

負債比例



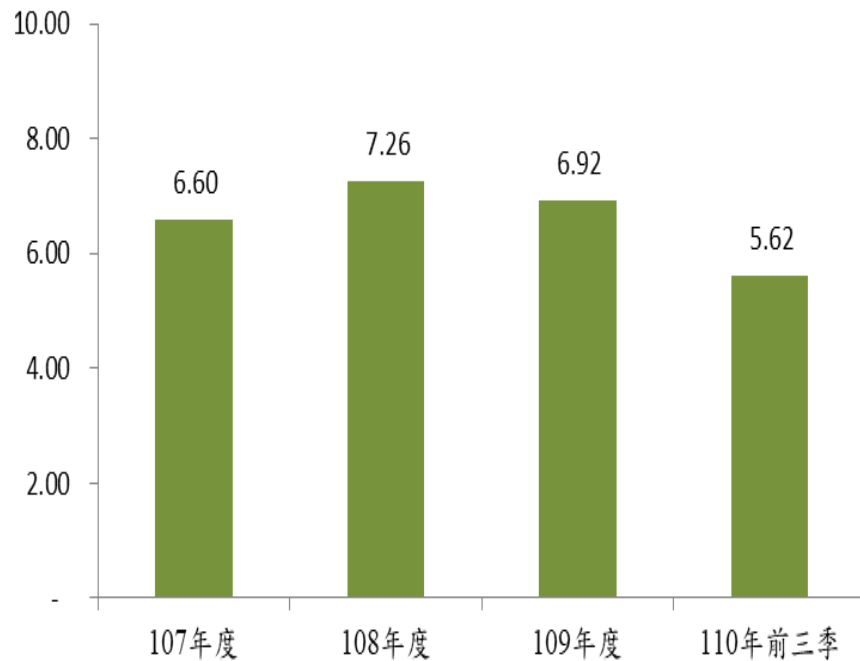
每股盈餘(元)



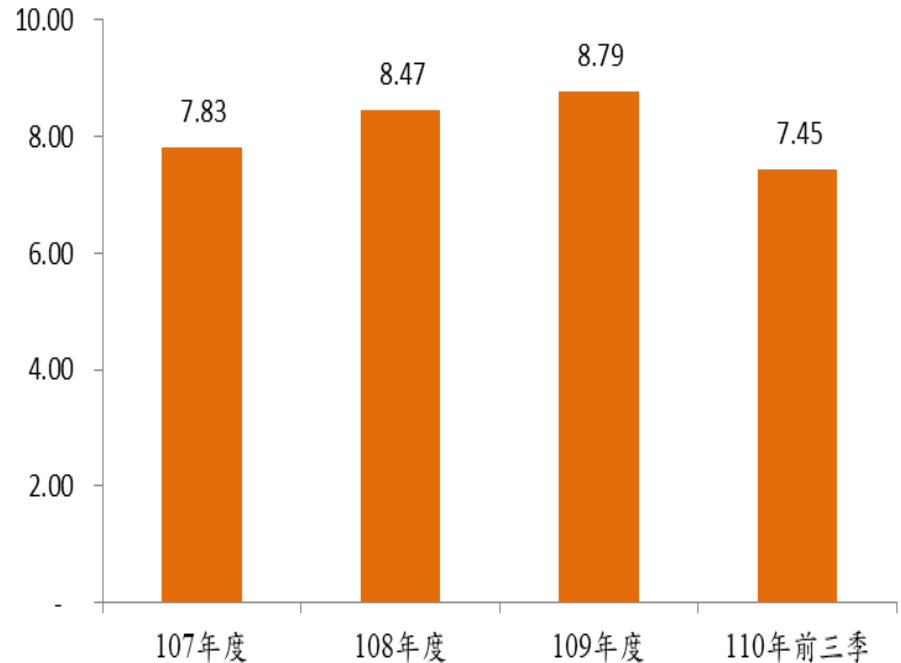
年度	107年度	108年度	109年度	110年前三季
負債比例	32.84	40.69	46.75	45.00
每股盈餘(元)	2.20	5.24	1.57	3.40

二、營運績效-財務比率分析

應收帳款周轉率



存貨周轉率



年度	107年度	108年度	109年度	110年前三季
應收帳款周轉率	6.60	7.26	6.92	5.62
存貨周轉率	7.83	8.47	8.79	7.45

三、市場狀況與業務展望-1 Metal COF for 大尺寸面板

✓ 目前：因為新冠肺炎疫情，影響消費造成需求較為疲弱

- * 因為新冠肺炎COVID 19疫情影響消費意願，以致需求較為疲弱。
- * 2021上半年電視市場需求在紓困補助刺激下，電視出貨年增10%。
- * 因上半年面板價格漲勢凌厲導致整機成本上升，下半年恐難見到以往的促銷破盤價，導致旺季不旺疑慮漸增，TrendForce下修電視出貨量年減0.9%。
- * 今年運輸時間因塞港問題進而導致終端上架時間延後3~4週，間接壓縮品牌在歐美地區的備貨量，使面板相關產業鏈第四季憑添變數。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變；需求時間遞延

- * TV面板 – 4K -> 8K趨勢已然呈現，Dual Cell。
- * Monitor/NB/Tablet面板 – 開始出現無邊框應用；由COG轉為COF的設計。
- * 車用面板 – 開始COF的設計。

三、市場狀況與業務展望 - 1 Metal COF for小尺寸面板

✓ 目前：手持式裝置用驅動IC設計趨勢更迭

- * 手機面板用驅動IC晶片，因為晶圓產能供應趨緊；加上COP設計增加，因此COF使用量降低。
- * 手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量日增。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變

- * 高階手機用軟性OLED – COP 增加，1-Metal COF減少
- * 中階手機用硬屏OLED/LTPS – FHD TDDI/FTDDI用1-Metal COF，部分用COG。
- * 低階手機用a-Si/LTPS – HD用COG，FHD TDDI用1-Metal COF。
- * 穿戴裝置 – 由於邊框要求，陸續由COG轉為1-Metal COF設計，市場有成長空間。

三、市場狀況與業務展望 - 2 Metal IC Substrate

✓ 目前：MiniLED直顯和背光市場並進，應用開枝散葉

- * LED小間距持續發力，隨著小間距顯示屏在顯示領域持續滲透以及成本的下降，未來P1.7-P2.0和P1.2-1.6將逐步成為主流，另外隨著消費者對於高清化需求增加，Mini LED預計在P1.1及以下的顯示屏將逐步進入市場。
- * 現階段Mini LED的晶片尺寸在50-200微米，可做背光使用；也可做為直接顯示。

✓ 未來：新設計、新應用...

- * 易華 2-Metal 技術 將成為MiniLED IC Substrate供應商之一。

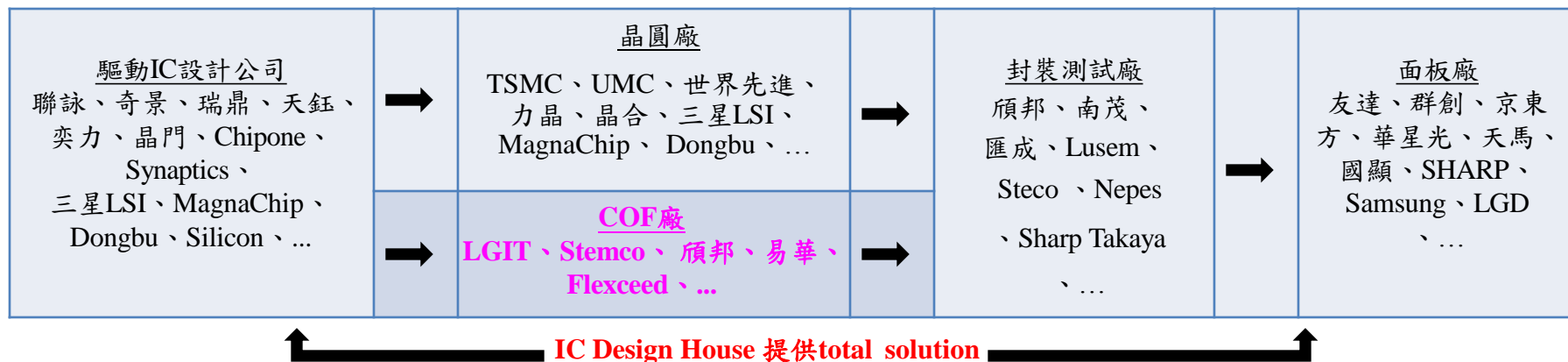
三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

✓ 提供客戶全方位軟性IC substrate產品之供應商

製程	競爭優勢	技術/應用	目標產品/新產品
1-Metal Sub 減成法	<ul style="list-style-type: none"> *生產速度快，效率高。 *技術能力自主，生產良率穩定。 	<ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~8um *線路\geq20um Pitch *腳數\leq1440 Channel/48mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ LCD TV @ OLED TV @ Dual Cell LCD
1-Metal Semi 半加成法	<ul style="list-style-type: none"> *高精度尺寸控制的COF產品，可以提升面板模組組裝良率；協助客戶降低Total Cost。 *生產良率高及品質穩定性佳，在生產成本上具有絕對的競爭優勢。 	<ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~12um *線路\geq18/16/14um Pitch *腳數\leq1900 Channel/48mm \leq3000 Channel/70mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ 智慧手機 @ 穿戴裝置 @ FoD @ FTDDI
2-Metal 雙面法	<ul style="list-style-type: none"> *新製程技術開發能力。 *具備設備設計能力。 *成本控制能力佳。 	<ul style="list-style-type: none"> *Thin Film IC Substrate *LED IC Substrate *腳數\leq2500 Channel/48mm \leq4000 Channel/70mm 	<ul style="list-style-type: none"> @ NAND Flash @ Mini LED @ Micro LED

四、產業概況-驅動IC供應鏈

✓ IC Design House提供total solution



✓ 目前具量產能力的COF廠5家，易華為台灣唯二供應商之一

製程技術		1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching)	1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating)	2-Metal(雙面)	
應用	腳數(Channel)/帶寬	=<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm	
		=<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm	
產能	韓國	S社	90~100KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	7-10KK
		L社	120~130KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	5-7KK
	日本	F社	20KK	X	2KK
	台灣	C社	70~90KK	X	X
		易華	40KK	40KK	5KK(裝機中)
	大陸	ESWIN Aplus	? ?	? ?	? ?

Q&A

